Power Assembly Engineer (パワーデバイスパッケージ)

募集職種

採用企業名
株式会社iSoftStone Japan

求人ID
1605945

業種
化学・素材

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

外国人の割合
外国人 半数

雇用形態
契約

勤務地
東京都 23区

給与
450万円 ~ 650万円

更新日
2026年10月29日 09:00

応募必要条件

職務経験
1年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
日常会話レベル

日本語レベル
ビジネス会話レベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

1. 高度なパワーエンカプラーシステム (材料およびプロセス) の開発を担当する
2. エンカプラー材料の専門家に対して、定期的なプロジェクトタスクの追跡をサポートできる
3. 材料の納品および分析作業において、専門家をサポートできる
4. 実験設計をサポートし、結果をまとめることができる

スキル・資格

More than 2 years related working experience in encapsulate material/equipment/process technology development.

会社説明